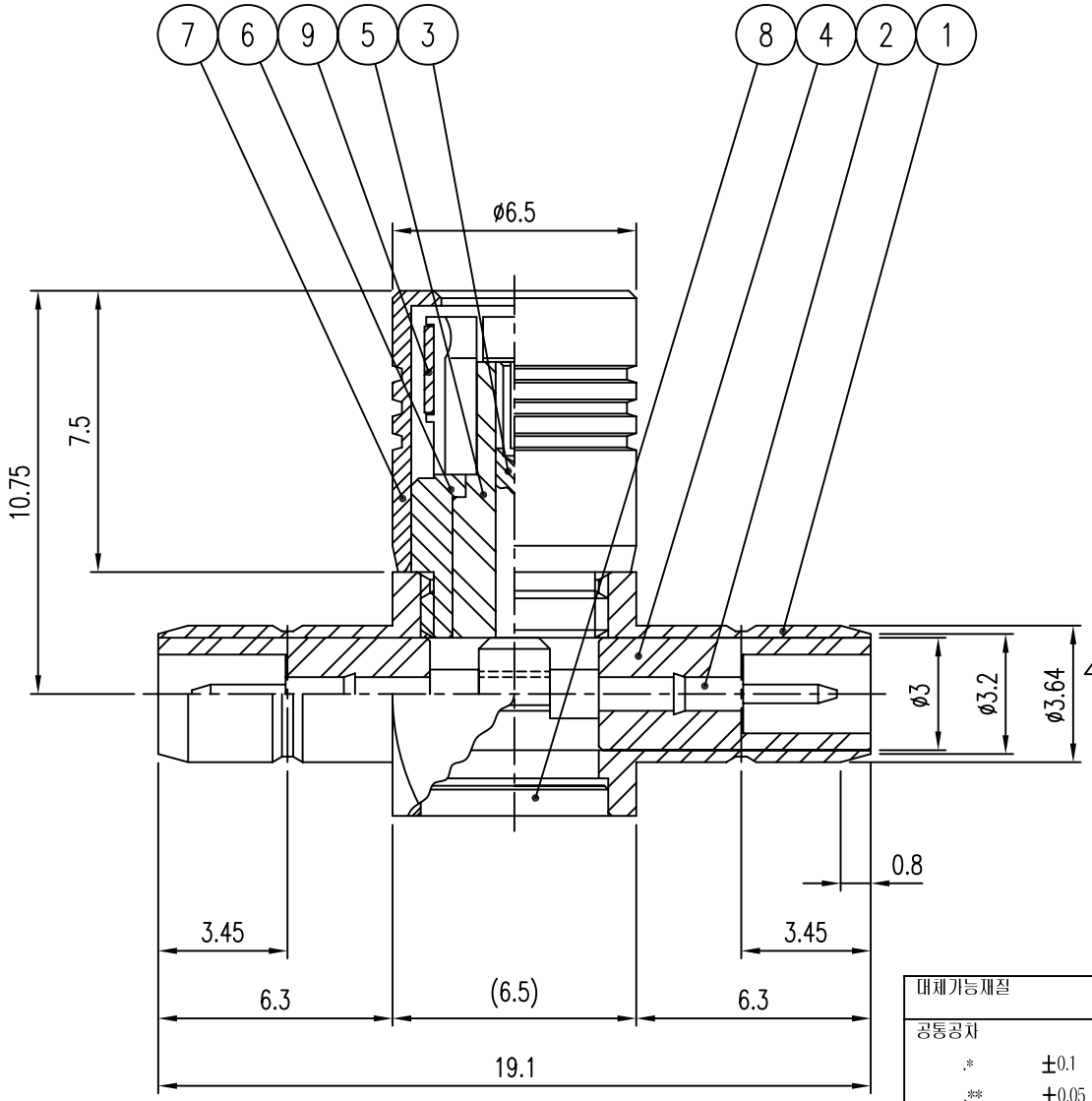
ST \ 가공									
ST(기존)									
ST(개선)									

수 정 내 용

부호	내 용	수정자	승인자	년 월 일
1	조립성 개선	손윤호	김기영	2001. 1. 18.
2	(설변처리No.201606-0001)Cover 들뜸 및 비정상적으로 안착되는 현상으로 인한 Cover CODE 변경	김찬경	김인철	2016. 6. 09.



품번	품 명	수량	재 질	표면처리	비 고
9	SPRING RING	1	BeCu	Gold Plate	DSR00004-N45/1 (R3001) DSR00004-5/2 (R3001)
8	COVER	1	MBsBD	Gold Plate	DCO00026-5/1 ~~DCO00031-15/1 (L2013)~~
7	CAP	1	MBsBD	Gold Plate	DCU0023-135/1 (K3004)
6	JACK	1	MBsBD	Gold Plate	DJA00031-135/1 (J3013)
5	INSULATOR	1	TEFLON		DIN00330-N/1 (H3049)
4	INSULATOR	2	TEFLON		DIN00292-N/1 (H3048)
3	CONTACT	1	BeCu	Gold Plate	DCT00362-1345/1 (E3040)
2	CONTACT	1	MBsBD	Gold Plate	DCT00343-15/1 (E3039)
1	BODY	1	MBsBD	Gold Plate	DBD00431-135/1 (D3041)

대체가능재질

공통공차
.* ±0.1
.** ±0.05

재질

열처리

보호피막처리

년월일	2016. 6. 09.
승인	김 인 철
검도	이 현 진
제도	김 찬 경
작성부서	연 구 소
척도 4/1	단위 mm 중량

KJ COMTECH
KJ COMTECH CO.,LTD.
RF & MICROWAVE TECHNOLOGY
Tel : 82-32-347-8015
Fax : 82-32-347-8017

도명 SMB-JPJ

A4

도번 AD00048-7/1

K315-780-000